



2025年1月7日

各位

キャリア付極薄銅箔「MicroThin™」生産体制の増強計画

～ 2030年に向けて70万㎡増加の560万㎡/月体制に～

当社（社長 納武士）は、キャリア付極薄銅箔「MicroThin™」について、2025年以降上尾事業所（埼玉県上尾市）およびマレーシア工場（Mitsui Copper Foil (Malaysia) SDN. BHD.）の生産能力を順次増強し、2027年度までに30万㎡、2030年までにさらに40万㎡増強し月産560万㎡とする計画であることをお知らせいたします。

当社のキャリア付極薄銅箔「MicroThin™」は、微細回路形成に適した1.5μm～5μmの銅箔厚みと複数種類の微細な粗化処理を組み合わせた製品であり、主に半導体パッケージ基板やスマートフォン用マザーボード（HDIプリント基板）に使用されております。

半導体パッケージ基板ではデータセンターや車載向けメモリー基板用途が増加しており、また光モジュールや超高速インフラ用多層基板、超高速通信用フレキシブル基板などの新規用途への採用拡大により需要が伸長していくものと考えております。

DX導入による製造工程のビッグデータ化およびデータサイエンスによる生産性の更なる向上や加工・検査工程等における設備の増強により、生産能力を月産490万㎡から560万㎡への増強を計画しております。

当社は、パーパスである「探索精神と多様な技術の融合で、地球を笑顔にする。」を基軸に、2030年のありたい姿である全社ビジョン「マテリアルの知恵で“未来”に貢献する、事業創発カンパニー。」を実現することで、サステナブル（持続可能）な社会作りに貢献します。

■ 「MicroThin™」生産能力（ご参考）

	2024年	2027年	2030年
上尾事業所	250万㎡/月	260万㎡/月	280万㎡/月
マレーシア工場	240万㎡/月	260万㎡/月	280万㎡/月
計	490万㎡/月	520万㎡/月	560万㎡/月

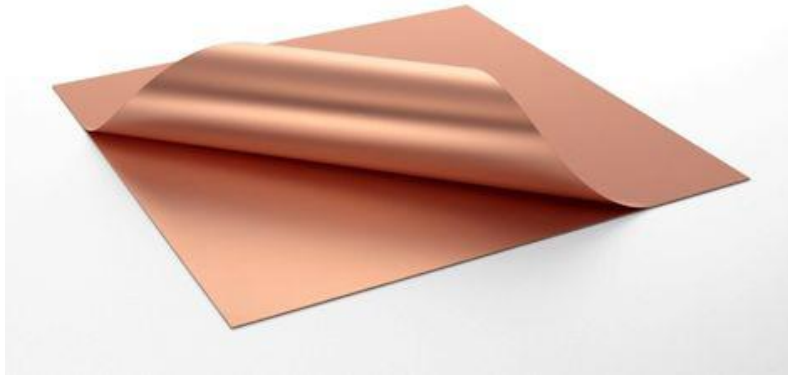
以上

【お問い合わせ先】

三井金属 経営企画本部 コーポレートコミュニケーション部

TEL : 03-5437-8028 Eメール : PR@mitsui-kinzoku.com

「MicroThin™」写真



上部：キャリア銅箔（厚み 18 μ m、12 μ m）

下部：極薄銅箔（厚み 1.5 μ m～5 μ m）